

V9 NO CLEAN LÖTPASTE

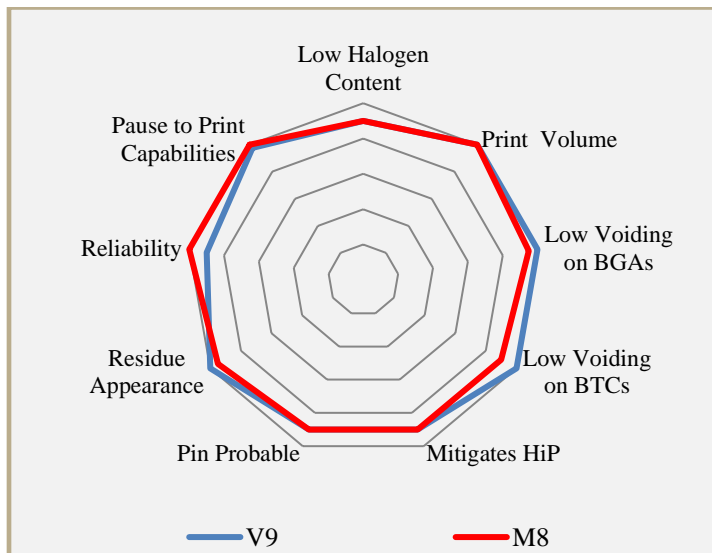
EIGENSCHAFTEN

- Geringe Lunckerbildung: bis zu 1 % bei BGAs und <5 % bei BTCs
- Konsistenter Druck mit einem Flächenverhältnis <0,66
- Hohe Verlässlichkeit (SIR)
- Einsetzbar für M8
- REACH- und RoHS*-konform
- Erhältlich in SAC305 T4

BECHREIBUNG

Die V9 No Clean Lötpaste ist so formuliert, dass bei BGA-, BTC- und LED-Lötanwendungen nahezu keine Luncker entstehen. Erhebliche Void-Reduzierung auf allen Oberflächen, einschließlich ENIG, ImSn und OSP, ist möglich. V9 zeigt eine stabile Druckleistung auf fein strukturierten Bauteilen über 12 Stunden. V9-Rückstände lassen sich nach der Verarbeitung leicht auf Pins testen und haben hohe SIR-Werte.

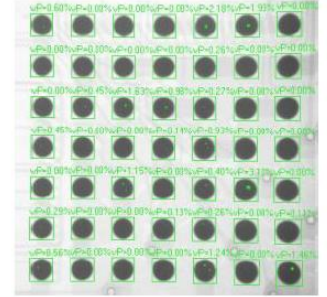
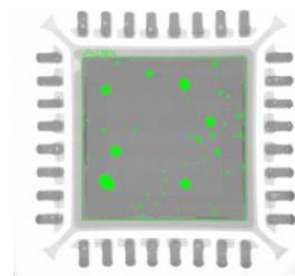
CHARACTERISTICS



*Lead-free alloys.

*Alle Informationen dienen nur als Referenz. Sie dürfen nicht als Spezifikationen für eingehende Produkte oder für die Prozessgestaltung verwendet werden. Für produktspezifische Informationen konsultieren Sie bitte das Analysenzertifikat.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf Daten, die für korrekt gehalten werden, und werden kostenlos angeboten. Die Produktinformationen beruhen auf der Annahme einer ordnungsgemäßen Handhabung und Betriebsbedingungen. Eine Haftung für Verluste oder Verletzungen, die sich aus der Verwendung dieser Informationen oder der Verwendung der angegebenen Materialien ergeben, wird ausdrücklich abgelehnt. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von AIM finden Sie unter <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> to review AIM's terms and conditions.



HANDHABUNG & LAGERUNG

PARAMETER	TIME	TEMPERATURE
Ungeöffnet & Gekühlt	6 Monate	0°C-12°C (32°F-55°F)
Ungeöffnet bei Raum-Temperatur	1 Monat	< 25°C (< 77°F)

Fügen Sie gebrauchte Paste nicht zu unbenutzter Paste hinzu. Lagern Sie gebrauchte Paste separat; bewahren Sie ungebrauchte Paste fest verschlossen mit dem inneren Stopfen oder der Endkappe auf. Nach dem Öffnen ist die Haltbarkeit der Lötpaste von der Umgebung und der Anwendung abhängig. Weitere Informationen finden Sie in den AIM-Richtlinien zur Handhabung von Pasten. Legierung und Lagerbedingungen können die Haltbarkeit beeinflussen. Produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem V9-Analysezertifikat.

REINIGUNG

Pre-Reflow: AIM DJAW-10 entfernt effektiv V9-Lotpaste von Schablonen während des Prozesses. DJAW-10 kann von Hand aufgetragen oder in der Unterseitenreinigung des Druckers verwendet werden. DJAW-10 trocknet V9 nicht aus und verbessert die Übertragungseigenschaften. Nicht zu viel DJAW-10 auftragen. DJAW-10 nicht auf die Schablonenoberseite auftragen. Isopropanol (IPA) wird für die Verarbeitung nicht empfohlen, kann aber zur abschließenden Spülung der Schablone verwendet werden.

Post-Reflow-Flussmittelrückstände: V9-Rückstände können nach dem Reflow-Prozess auf der Baugruppe verbleiben und müssen nicht gereinigt werden. In Fällen, in denen eine Reinigung vorgeschrieben ist, hat AIM eng mit Industriepartnern zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass V9-Rückstände mit gängigen Reinigungsmitteln effektiv entfernt werden können. Wenden Sie sich an AIM, um Informationen zur Reinigungscompatibilität zu erhalten.




REFLOW PROFIL

Ausführliche Profilinformatoren finden Sie unter <http://www.aimsolder.com/reflow-profile-supplements>. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an AIM.

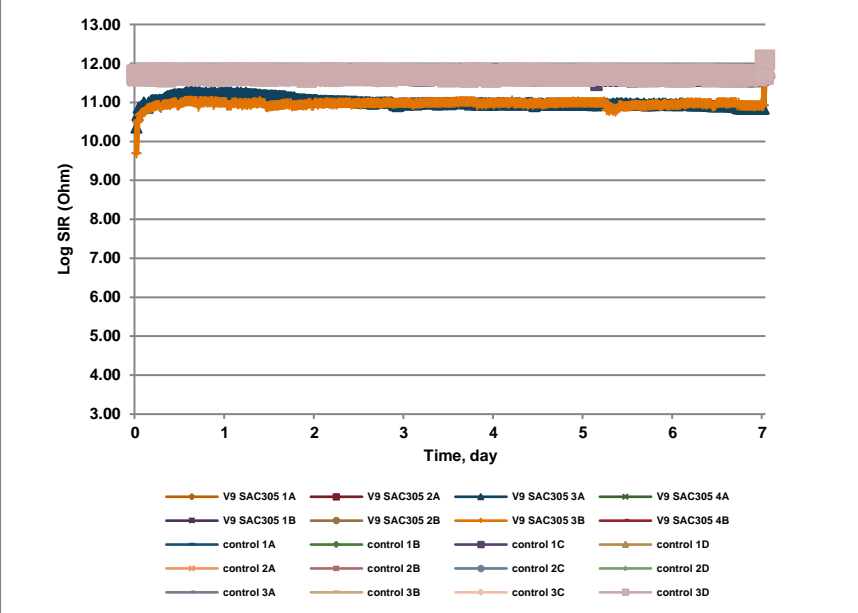
DRUCKEN

EMPFOHLENE ANFÄNGLICHE DRUCKEREINSTELLUNGEN - ABHÄNGIG VON PCB UND PAD-DESIGN	
Parameter	Empfohlene Anfangseinstellungen
Rakel-Druck	0.4 - 0.7kg/25mm
Rakel-Geschwindigkeit	13 – 152 mm/Sekunde
Absprung-Distanz	Auf Kontakt 0.00 mm
PCB Trennungs-Abstand	0.75 - 2.0 mm
PCB Absprung-Geschwindigkeit	3 - 20 mm/Sekunde


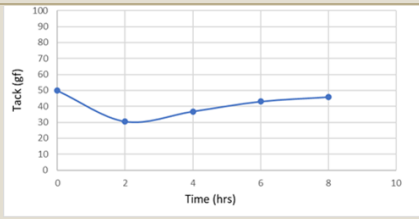
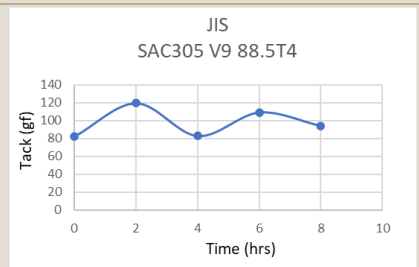
ZUSAMMENFASSUNG TEST-ERGEBNISSE

NAME	TEST METHODE	ERGEBNIS	
IPC Flux Classification	J-STD-004 3.3	ROLO	
IPC Flux Classification	J-STD-004B 3.3	ROL1	
NAME	TEST METHODE	TYPISCH	ABBILDUNG
Copper Mirror	J-STD-004B 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32	Niedrig	
Corrosion	J-STD-004B 3.4.1.2 IPC-TM-650 2.6.15	PASS	
Quantitative Halides	J-STD-004B 3.4.1.3 IPC-TM-650 2.3.28.1	Br: 0.44% Cl: 0.0% Typical	
Qualitative Halides, Silver Chromate	J-STD-004B 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33	PASS	
Qualitative Halides, Fluoride Spot	J-STD-004B 3.5.1.2 IPC-TM-650 2.3.35.1	PASS	

DISCLAIMER The information contained herein is based on data considered accurate and is offered at no charge. Product information is based upon the assumption of proper handling and operating conditions. Liability is expressly disclaimed for any loss or injury arising out of the use of this information or the use of any materials designated. Please refer to <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> to review AIM's terms and conditions.

NAME	TEST METHODE	TYPISCH	ABBILDUNG
Surface Insulation Resistance	J-STD-004B 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.7	All measurements on test patterns exceed 100 MΩ	 <p>The graph displays the Log SIR (Ohm) over a 7-day period for 14 different samples. The y-axis is labeled 'Log SIR (Ohm)' and ranges from 3.00 to 13.00 in increments of 1.00. The x-axis is labeled 'Time, day' and ranges from 0 to 7. The legend includes: V9 SAC305 1A-4A, V9 SAC305 1B-4B, control 1A-4D, and control 2A-4D. All data series show a sharp initial increase from day 0 to day 1, reaching a plateau between 10.5 and 12.0, which remains stable through day 7.</p>
Flux Solids, Nonvolatile Determination	J-STD-004B 3.4.2.1 IPC-TM-650 2.3.34	94.14% Typical	
Acid Value Determination	J-STD-004B 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13	139.03 mgKOH/g Typical	
Viscosity (Malcom)	J-STD-005A 3.5.1 IPC-TM-650 2.4.34	130-200 Pa's Typical	
Visual	J-STD-004B 3.4.2.5	PASS	
Slump	J-STD-005A 3.6 IPC-TM-650 2.4.35	PASS	
Spread Test	J-STD-004B 3.7.2 IPC-TM-650 2.4.46	PASS	

DISCLAIMER The information contained herein is based on data considered accurate and is offered at no charge. Product information is based upon the assumption of proper handling and operating conditions. Liability is expressly disclaimed for any loss or injury arising out of the use of this information or the use of any materials designated. Please refer to <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> to review AIM's terms and conditions.

Solder Ball	J-STD-005A 3.7 IPC-TM-650 2.4.43	PASS	 <p style="text-align: center;">15 min 4 hrs</p>
Tack	J-STD-005A 3.8 IPC-TM-650 2.4.44	36.1 gf Time 0 Typical	
Tack	JIS Z 3284 Annex 9	82.5 gf Time 0 Typical	<p style="text-align: center;">JIS SAC305 V9 88.5T4</p> 

DISCLAIMER The information contained herein is based on data considered accurate and is offered at no charge. Product information is based upon the assumption of proper handling and operating conditions. Liability is expressly disclaimed for any loss or injury arising out of the use of this information or the use of any materials designated. Please refer to <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> to review AIM's terms and conditions.